

Prüfung von Verbundwerkstoffen

Bindungsprüfung im C-Bild



- Prüfen von Wabenstrukturen
- C-Bild-Anzeige
- Prüfen mit bis zu 8 Frequenzen gleichzeitig
- Anwenderfreundliches Design

Verbesserte Bindungsprüfung

Acht Frequenzen im gleichen Prüfdurchgang



Verbesserte Bindungsprüfung

- C-Bild-Anzeige
- Prüfen mit acht Frequenzen gleichzeitig
- Größenbestimmung
- Verbesserte Wahrscheinlichkeit der Fehlererkennung
- Anzeigenmodus Phase/Amplitude



Wichtige Punkte

- Fehlererkennung wie mit dem Gerät BondMaster 1000e+, da die gleichen Sonden eingesetzt werden
- Sender-Empfänger-Sonden
- Erfasst das C-Bild mit einem zweiachsigen Scanner

Prüfung von Verbundwerkstoffen auf dem Stand der Technik

Mit einem tragbaren Gerät lassen sich einfach ablesbare C-Bilder generieren. Diese OmniScan Lösung eignet sich hervorragend zum Prüfen des Haftverlusts von Verbundwerkstoffen mit Wabenstruktur und zur genauen Prüfung von Delaminationen. Sie wurde vor allem für Wartungsprüfungen in der Luftfahrtindustrie entwickelt, eignet sich aber ebenso gut in der Produktion, z. B. im Fahrzeug- und Schiffsbau (wie zur Prüfung von Schiffsrümpfen aus Verbundwerkstoff).

Wenn bereits ein OmniScan ECA- oder ECT-Modul vorhanden ist, müssen für eine Komplettlösung nur die BondMaster Standardsonden (P14 und SPO-5629) und das BondMaster Kabel bestellt werden.

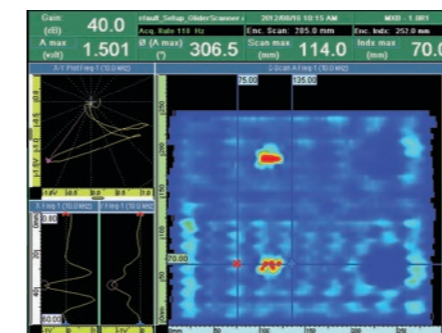
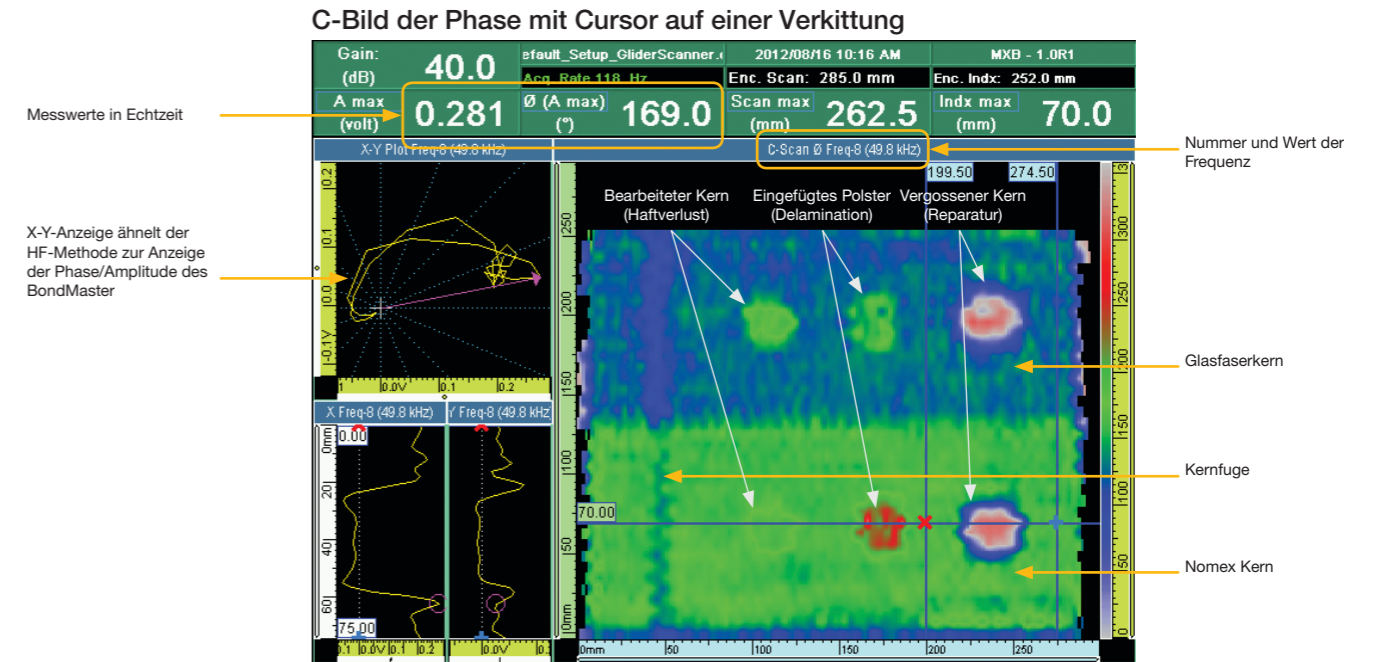
Die Software MXB wurde speziell für die Prüfung von Verbundwerkstoffen entwickelt. Neue Funktionen, wie der Assistent und die Normalisierung, tragen wesentlich zur Bedienfreundlichkeit der Lösung bei.



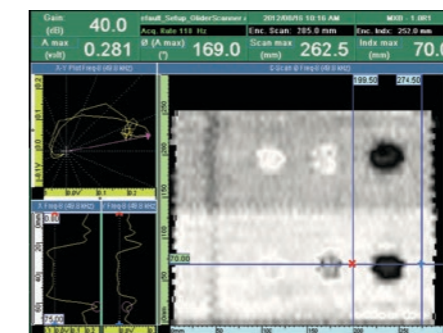
System mit Weggeber: Alle Scanner mit Weggeber auf zwei Achsen können zur Prüfung eingesetzt werden. Olympus bietet zwei Möglichkeiten an: den GLIDER Scanner, der sich bestens für flache oder leicht gekrümmte Flächen eignet, und den WING-Scanner, der speziell für gekrümmte Teile (wie Flugzeugrümpfe) ausgelegt ist. Dank seiner Vakuumsaugfüße kann der WING Scanner sogar überkopf eingesetzt werden. Um die Einsatzflexibilität zu erhöhen, ist auch ein Handscanner mit Weggeber auf einer Achse und externem Taktgeber mit dem System kompatibel.

Innovative C-Bild-Anzeige

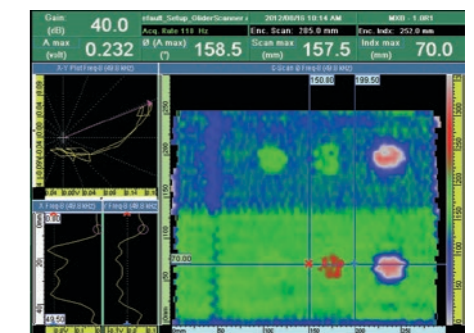
Für jedes C-Bild stehen zwei Anzeigeeoptionen zur Verfügung: das C-Bild der Amplitude, in dem auf der Signalamplitude, ungeachtet der Phase basierende Farbvariationen angezeigt werden, die ideale Anzeigart für klares und zügiges Erkennen von Haftverlust, oder das C-Bild, mit einer Farbpalette von 0° bis 360°, die die Änderungen des Phasenwinkels anzeigt und die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Fehlerindikationen erleichtert, wie z. B. zwischen Kitt (Reparatur) und Ablösung.



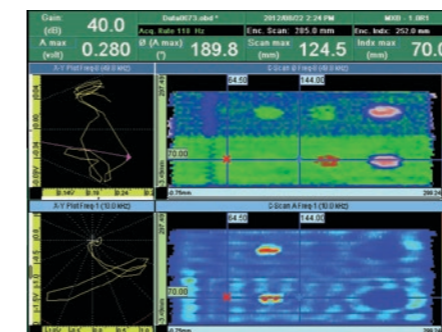
Niederfrequenter Scan, C-Bild der Amplitude mit Cursor auf einer Ablösung



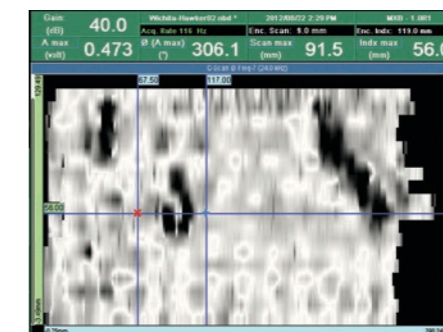
Hochfrequenter Scan, C-Bild der Phase mit einer anderen Farbpalette



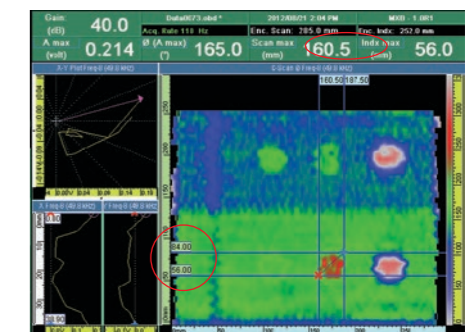
Hochfrequenter Scan, C-Bild der Phase mit Cursor auf einer Delamination



Zwei C-Bild-Anzeigen



C-Bild-Anzeige auf dem gesamten Anzeigebereich

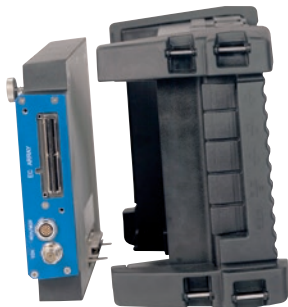


Funktion zur Einschätzung der Fehlergröße

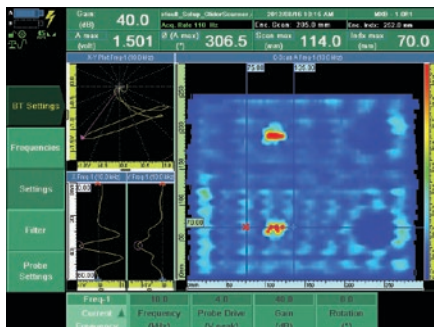
Erforderliches Zubehör

Diese Lösung ist in zwei Konfigurationen erhältlich. Beide Ausführungen erfordern die folgenden Standardkomponenten.

Standardkomponenten



OmniScan MX mit ECA- oder ECT-Module



Software MXB



BondMaster Sondenadapter für OmniScan

Manuelle Konfiguration



Handscanner HSB-01

Halbautomatische Konfiguration



Scanner mit zwei Achsen*



Sonde SPO-5629-PHV mit Sondenaufnahme ACIX1520



Sonde S-PC-P14 mit Sondenaufnahme ACIX1519

Bestellangaben

Teilenummer	Bestellnummer	Beschreibung
OMNI-A-OBTC	U8779469	Kit für Bindungsprüfung mit OmniScan ECA/ECT, Adapter und Software MXB
ACIX1519	U8780314	Sondenaufnahme und Spanner, erforderlich zur Befestigung der BondMaster Sonde P14 am Scanner mit zwei Achsen
ACIX1520	U8780315	Sondenaufnahme und Spanner, erforderlich zur Befestigung der BondMaster Sonde SPO-5629 am Scanner mit zwei Achsen
9323945	U8800601	Sonde S-PC-P14: federbelastete Sondenspitzen, Ankopffläche 15 mm, Hochspannung
9322184	U8010039	Sonde SPO-5629-PHV: federbelastete Sondenspitzen, Ankopffläche 13 mm, Hochspannung
9117789	U8800058	SBM-CPM-P11: Kabel 11-polig auf 11-polig für Sender-Empfänger- und MIA-Sonden
HSB-01	U8270154	Handscanner zur Bindungsprüfung mit Kabel und Weggeber (Sonde S-PC-P14 NICHT inbegriffen)
HSB-SPCP14	U8270153	Handscanner HSB-01 zur Bindungsprüfung mit Sonde S-PC-P14, Kabel und Weggeber

* Der GLIDER und der WING Scanner von Olympus können für die halbautomatische Konfiguration eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Produktverfügbarkeit ist landes-/regionsabhängig. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren zuständigen Olympus Händler.

www.olympus-ims.com

OLYMPUS

Anfragen an
www.olympus-ims.com/contact-us

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG
Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg, Deutschland, Tel.: (49) 40-23773-0
OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH
Wendenstraße 14-18 20097 Hamburg, Tel.: (49) 40-23773-0
OLYMPUS AUSTRIA GES.M.B.H.
Shuttleworthstraße 25, 1210 Wien, Tel.: (43) 1 29101-248

OLYMPUS SCIENTIFIC SOLUTIONS AMERICAS CORP.
ist gemäß ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Firmen- und Warennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Eigentümers oder eines Dritten.
Copyright © 2018 Olympus NDT.